

株主メモ

上場証券取引所 東京証券取引所 マザーズ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
株式の売買単位 100株
公告方法 公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL <http://www.teraprobe.com/>
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 〒183-8701
東京都府中市日鋼町1番10
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 ☎0120-176-417

< 平成25年1月より郵便物送付先・電話照会先が変更となります >
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
☎0120-782-031

インターネット <http://www.smtb.jp/personal/agency>
ホームページURL

ホームページのご案内

当社では、株主・投資家の皆様にプレスリリースや決算説明資料などのIR情報をホームページにて公開しております。是非、ご覧ください。



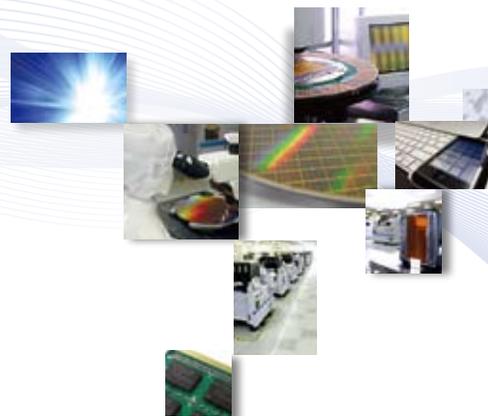
株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17
TEL:045-476-5711

ホームページアドレス <http://www.teraprobe.com/>

ターンキーサービスで新たな価値を創造する

Tera Probe



第8期

中間ビジネスレポート

テラプローブ ビジネスレポート 2012

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



2012年度上期は、欧米先進国では景気の低迷が続き、新興国の成長も減速傾向となり、世界経済は力強さを欠く展開となる中、円高の長期化や電力料金の値上げなど、国内経済も先行き不透明となっております。

当社グループが属する半導体業界におきましては、国内半導体企業において人員削減が実施されるなど引き続き厳しい事業環境が継続しております。

このような状況の下、当社グループは従来から引き続き新規顧客の取り込みや新規受託を目指し営業活動を展開してまいりました。その結果、当上期には新たに照明用LED(発光ダイオード)素子のテストを受託することが出来ました。

今後も、新分野のテスト受託を目指すとともに、半導体生産の中心地である台湾での事業拡大を目標に、グループ一丸となって営業活動を強化してまいりますので、引き続きご支援をお願い申し上げます。

代表取締役社長兼CEO
渡辺 雄一郎

当上期における当社グループの業績は、テスト受託は横ばいで推移したものの、ウエハレベルパッケージ(WLP)受託が一部製品の生産調整などで減少し、売上高が115億6百万円(前年同期比2.0%増)、営業利益が4億70百万円(同74.5%減)となりました。

◆メモリ事業について

セグメント別の業績は、メモリ事業では、前四半期と比較し、主たる受託品であるDRAMにおいて、テスト時間の長い製品の受託量は増加いたしました。テスト時間の短い製品の受託量が市況の悪化などから低調に推移し、売上高が80億89百万円(前年同期比21.1%減)、セグメント利益が12億29百万円(同55.7%減)となりました。

◆システム LSI 事業について

システムLSI事業では、テスト受託は、5月を底に受託量が増加しましたが、WLP受託は、当社グループが受託している製品の一部で生産調整があったことなどから受託量が大きく減少し、売上高は34億36百万円(前年同期比227.7%増)、セグメント損益は12百万円の損失(前年同期は3億60百万円の損失)となりました。

WLPとは

WLPとは、ウエハレベルパッケージ(Wafer Level Package)の略称であり、ウエハ状態(レベル)でパッケージ最終工程まで処理して完成するチップサイズパッケージ(Chip Size Package = CSP)です。

DRAMとは

半導体記憶素子の一つ。読み書きが自由に行えるRAMの一種で、大容量化が容易だが、一定時間ごとに再書き込みが必要で、電源が切れると記憶内容が消去されてしまいます。大きなデータを使うPCやスマートフォンで使用されます。

スマートフォンの普及とビジネスチャンス

世界的な携帯電話(フィーチャーフォン)の普及に続き、現在スマートフォンが普及しはじめています。先進国では、通常の携帯電話の台数を上回る数量のスマートフォンが販売されており、今後は新興国でもスマートフォンが販売の中心になるものと予想されています。

このスマートフォンの普及は当社グループのビジネスとどのように関係しているのでしょうか。

ご存じのようにPCをはじめ、通信機器、家電製品など我々の周りにある多くの製品に半導体は使用されています。特に、最近販売台数が増加しているスマートフォンやタブレット型端末は様々な機能が搭載されており、1台の機器にとっても多くの半導体が使われています。それでは、スマートフォンで使われる半導体にはどのような機能が求められるのでしょうか。

皆さんは、スマートフォンを使用していてどのような点を改善して欲しいと思いますか?多くの人は、バッテリーの持ちを良くして欲しいと感じているのではないのでしょうか。バッテリーを長持ちさせるためには、いくつかの解決策があります。

一つは、バッテリーの容量をなるべく大きくすることです。容量が大きくなれば、当然使用できる時間も長くなります。しかし、一方では機器の大きさはあまり大きくできないという制限もあります。今以上に大きくなると、片手で操作しにくくなったり、持ちにくくなったりしてしまいます。

それではどうやって決められた大きさのまま、電池の容量を増やせばよいのでしょうか。

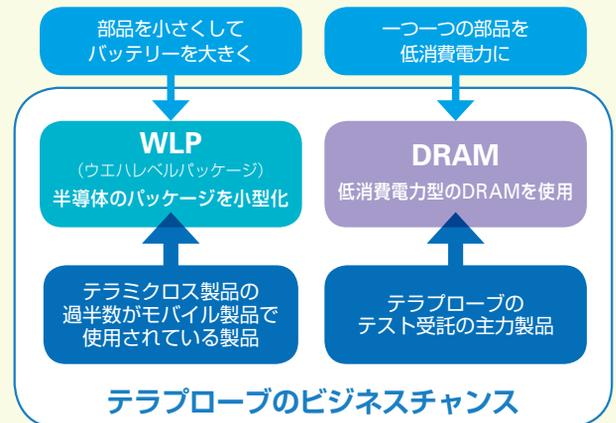
そうです。バッテリー以外の部品を小さくすればよいのです。とはいえ、今使える機能が使えなくなると元も子もありませんので、機能を落とさず部品を小型化しなければなりません。

そこで有効な方法が半導体チップの大きさやパッケージを極力小さくすることです。サイズの小さなパッケージの代表がWLPで、当社グループのテラミクロスで生産するWLPは、その構造から耐久性に優れているという特徴があります。そして、現在テラミクロスで生産している製品の過半数がスマートフォンなどのモバイル製品で使用されています。

もう一つは、一つ一つの部品を省電力化することです。最近の高機能化するスマートフォンでは、いろいろな機能を素早く動作させるために大容量のDRAMを搭載する傾向にあります。DRAMはその特性上、常に電力を消費しますので、この消費電力を少しでも減らすため、低消費電力型のDRAMが使用されます。この低消費電力型のDRAMは当社のテスト受託の売上で大きな比率を占めています。

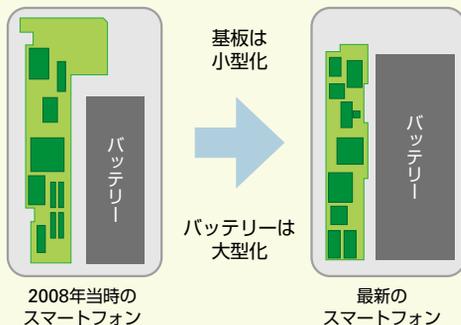
このように、皆さんが日頃お使いのスマートフォンには、当社グループがいろいろな形で関わっており、世界的なスマートフォンの普及は当社グループにとって、とても大切なビジネスチャンスとなっております。

◎スマートフォンのバッテリーを長持ちさせるには



■ スマートフォンの進化とWLPの役割

WLPは、主に小型・薄型、軽量、高性能、高信頼性、低コスト、省材料などの特長を有し、半導体パッケージの小型化の流れからも注目されており、“究極のパッケージ”と言われています。



■ 身近なWLPの役割

スマートフォン、タブレット型端末に限らず、PC、プリンター、大型液晶TV、デジタルカメラなど、今では私たちの暮らしに欠かすことの出来ない、多様なデジタル機器にWLPは用いられています。



- ・チューナー部
- ・電源部
- ・メモリ部
- ・システム制御部
- ・表示部
- ・アプリケーション部
- ・その他USBスイッチ等



- ・出力部
- ・電源部
- ・システム制御部
- ・メモリー部

その他の使用例



- ・入力部
- ・電源部
- ・システム制御部
- ・表示部
- ・インターフェイス部
- ・その他Audioアンプ等

- ・プリンター
- ・PC
- ・時計
- ・大型TV
- ・自動車

■ 今後のスマートフォン市場について

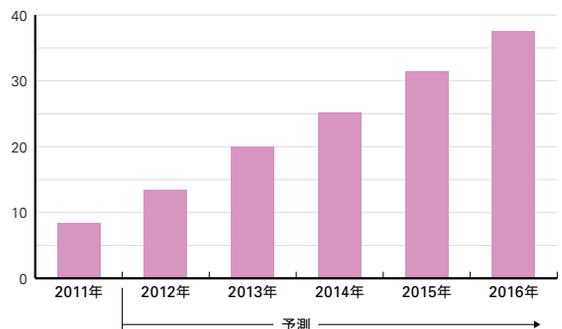
市場調査会社によると、『スマートフォンのグローバル市場は急速に伸びており、2016年には単年度の販売台数が12億台に達する』と予想されています。保有台数は、2016年末37億4,600万台、人口普及率で50%近くに達する見込みです。

先進国では、LTE(Long Term Evolution)に代表される4G(第4世代移動通信システム)などの次世代通信インフラの整備も急ピッチで進んでいます。3Gよりも更に沢山のデータのやり取りが可能になると、スマートフォンの高性能化、すなわちCPUの高速化とDRAM(メモリ)の大容量化が必要になります。

また、タブレット型端末も、7～10インチサイズの新モデルが各社から相次いで発表され、メーカー間の競争がより激しくなると同時に、販売価格が下がり、着実に売上を伸ばしています。

このように、モバイル機器向けのDRAMや小型薄型パッケージの需要は今後ますます増加していくものと考えられます。

世界のスマートフォン普及台数予測 (単位：億加入)



各種資料より当社推計

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	前期末 (2012年3月31日)	当上期末 (2012年9月30日)
〈資産の部〉		
流動資産合計	10,675	9,506
固定資産合計	30,412	26,641
資産合計	41,088	36,147
〈負債の部〉		
流動負債合計	11,298	7,642
固定負債合計	8,591	7,086
負債合計	19,890	14,728
〈純資産の部〉		
株主資本合計	19,645	20,010
その他の包括利益累計額	△298	△394
少数株主持分	1,851	1,802
純資産合計	21,198	21,419
負債純資産合計	41,088	36,147

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	前上期 (2011年4月1日～2011年9月30日)	当上期 (2012年4月1日～2012年9月30日)
売上高	11,279	11,506
売上原価	8,533	9,883
売上総利益	2,746	1,623
販売費及び一般管理費	897	1,152
営業利益	1,848	470
営業外収益合計	88	40
営業外費用合計	254	205
経常利益	1,683	305
特別利益合計	105	125
特別損失合計	30	1
税金等調整前四半期純利益	1,759	429
法人税等	689	△17
少数株主利益	94	82
少数株主損益調整前四半期純利益	1,069	447
当期純利益	974	365

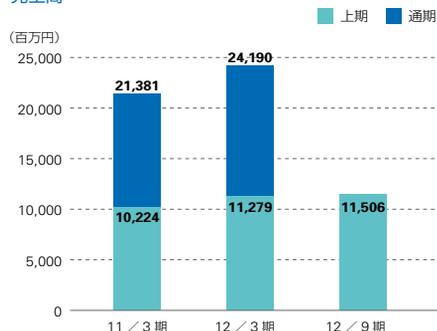
連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	前上期 (2011年4月1日～ 2011年9月30日)	当上期 (2012年4月1日～ 2012年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,252	4,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,992	△2,244
財務活動によるキャッシュ・フロー	△218	△2,577
現金及び現金同等物に係る換算差額	△44	△35
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	△2,003	94
現金及び現金同等物の期首残高	7,211	5,557
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,207	5,651

売上高

(百万円)



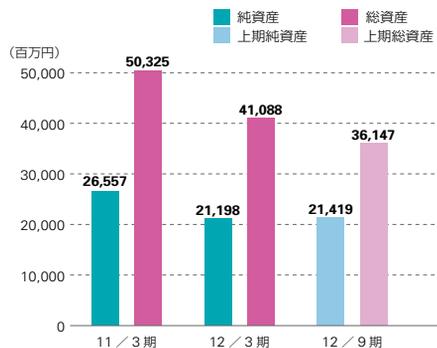
経常利益・純利益

(百万円)



純資産・総資産

(百万円)

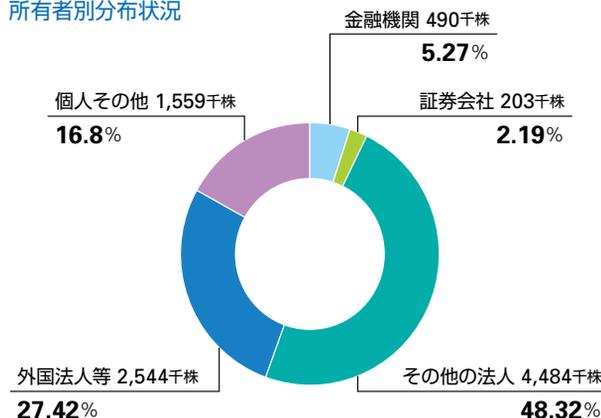


会社が発行する株式の総数	30,000,000 株
発行済株式の総数	9,282,500 株
株主数	2,844 名

大株主の状況

株主名	所有株式数(株)	持株比率(%)
エルピーダメモリ株式会社	3,680,000	39.64
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,129,300	12.17
株式会社アドバンテスト	760,000	8.19
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	451,800	4.87
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED	352,500	3.80
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	249,700	2.69
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	179,300	1.93
UBS AG HONG KONG	175,200	1.89
BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN	148,400	1.60
株式会社 SBI 証券	102,200	1.10
計	7,228,400	77.87

所有者別分布状況



社 名 テラ株式会社テラプローブ
(英文: Tera Probe, Inc.)

設 立 2005年8月

資 本 金 11,823百万円

従 業 員 295名(単体)、666名(連結)

事 業 内 容 ●メモリ事業
(DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託)

●システムLSI事業
(SoC、イメージセンサ、アナログ等 各種半導体製品のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託)

事業拠点



役員の状況 (2012年9月30日現在)

代表取締役社長 渡 辺 雄一郎

代表取締役副社長 小 平 広 人

取 締 役 横 山 毅

社 外 取 締 役 高 木 裕

常 勤 監 査 役 増 子 尚 之

監 査 役 縣 啓 二

監 査 役 森 直 樹